

产品规格书

DATA SHEET

客户名称 : _____

产品名称 : 三相整流桥 _____

产品型号 : ST50**W _____

产品描述 : 玻璃钝化芯片整流桥
50A (800-1600V) _____

物料编码 : 无 _____

制作人	审核	核准

客户确认 Customer Signature

乐山希尔电子股份有限公司

中国，四川省，乐山市高新技术开发区南新路 9 号 (614000)

网址 : www.share-leshan.com.cn

电话 : 0833-2595818/2595870/2599163

传真 : 0833-2595622

50A 三相整流桥**特征 Features**

玻璃钝化芯片

Glass passivated chip

低反向漏电流

Low Reverse Leakage Current

高耐浪涌电流能力达500安培

High surge current capability to 500Amperes

符合ROHS要求

ROHS compliance

高温焊接保证：260°C±5°C/10秒，拉力2.3 Kgf.cm

High temperature soldering guaranteed: 260°C±5°C/10 seconds (2.3 Kgf.cm)tension

机械参数 Mechanical Data

本体：灌封

Case :Embedment

极 性：极性符号铸在管体上

Polarity : Polarity symbols being marked on body

重 量：约17克

Weight : About 17 grams

最大额定值 Maximum Ratings Parameter @ Ta = 25°C unless otherwise noted

名词解释	参数条件		符号	08	10	12	14	16	单位
反向重复峰值电压 Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage			V_{RRM}	800	1000	1200	1400	1600	V
反向不重复峰值电压 Reverse non-repetitive peak voltage			V_{RSM}	900	1100	1300	1500	1700	V
最大直流电压 Maximum DC Blocking Voltage			V_{DC}	800	1000	1200	1600	1600	V
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	50Hz 正弦波负载, 50Hz sine wave load	带散热片, TC=85°C with heatsink, TC=85°C	$I_{(AV)}$	50					A
最大正向浪涌电流 Peak Surge Forward Current	50HZ 正弦波, 一个周期, $T_j=25^{\circ}\text{C}$ 50HZ sine wave, 1 cycle, $T_j=25^{\circ}\text{C}$		I_{FSM}	500					A
热容值 Rating for fusing	1ms<t<8.3ms, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, 单个二极管 1ms<t<8.3ms, $T_j=25^{\circ}\text{C}$, Rating of per diode		I^2t	1037					A ² s
结温 Junction temperature			T_J	-55 ~ +150					°C
存储温度 Storage Temperature			T_{STG}	-55 ~ +150					°C
绝缘耐压 Dielectric Strength	端子与外壳之间外加交流电 1 分钟 Terminals to case AC 1 minute		V_{ids}	2.5					KV
安装扭矩 Mounting torque	推荐扭矩: 5kg·cm recommend torque: 5kg·cm		Tor	12					Kg·cm

电性特性 Electrical Characteristics (Ta=25°C Unless otherwise specified)

正向峰值电压 Peak Forward Voltage	IF=25A, 脉冲测试, 单个二极管的额定值 IF=25A,Pulse measurement, Rate of per diode	Ta=25℃	V _F	1.1	V
反向峰值电流 Peak Reverse Current	VR=VRRM, 脉冲测试, 单个二极管的额定值 VR=VRRM, Pulse measurement Rating of per diode	Tj=25℃	I _R	5	μA
		Tj=125℃		500	
热阻 Thermal resistance	结到环境的热阻,无散热片 Junction to ambient , without heatsink		R _{θJA}	28	℃/W
	结到管壳的热阻,有散热片 Junction to case , with heatsink		R _{θJC}	0.9 ⁽¹⁾	

备注: 1、安装在 100mm×100mm×1.6mm 铝板散热器上的装置
Device mounted on 100mm x 100mm x 1.6mm Al Plate Heatsink

50A 特性曲线

FIG.1 . Derating Curve For Output Rectified Current

图 1. 电流降额曲线

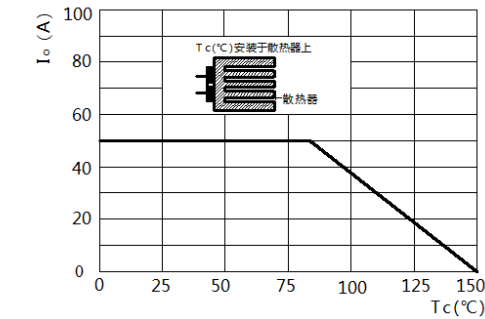


FIG.2 . Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current

图 2. 最大正向不重复峰值浪涌电

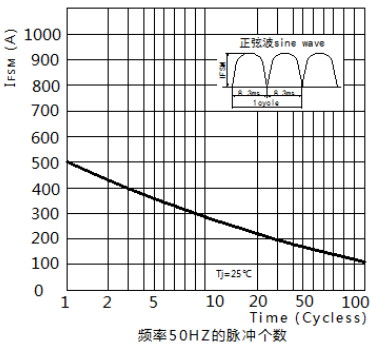


FIG3. Typical Reverse Characteristics Per Bridge Element

图 3. 典型反向特性

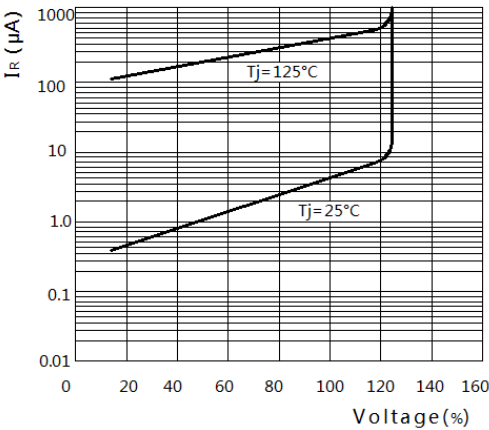
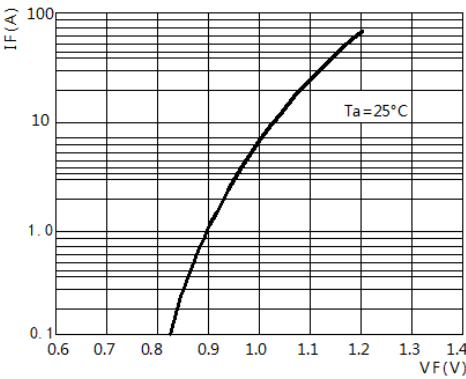
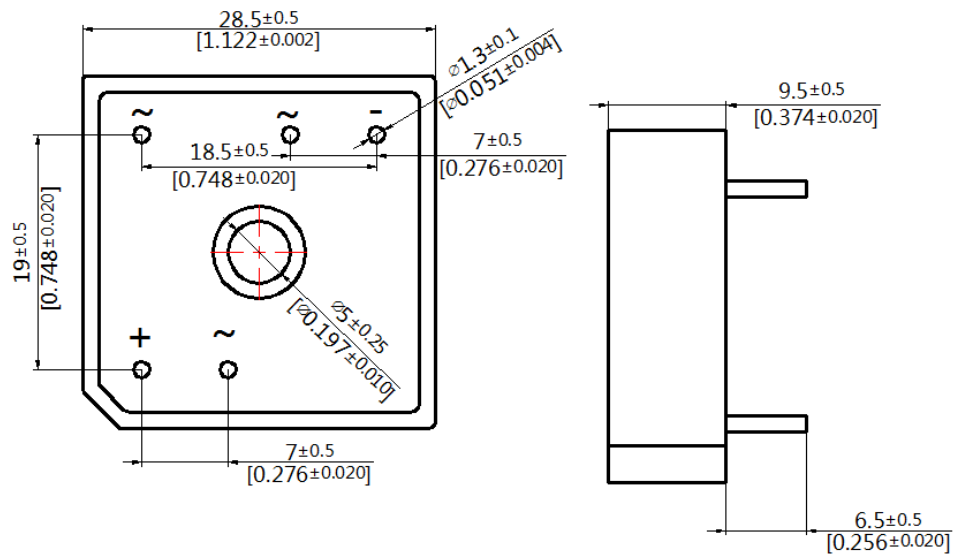


FIG4. Typical Forward Characteristics Per Bridge Element

图 4. 典型正向特性

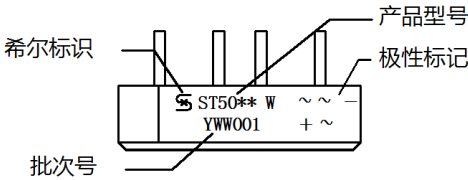


尺寸图
Dimensioned drawing



Dimensions in millimeters and inches

外形图
Outside view



注： ST-W 表示封装代码，50 表示电流 50A，** 为反向峰值电压 VRRM，核算公式=数值*100